

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年11月25日(2021.11.25)

【公開番号】特開2020-61449(P2020-61449A)

【公開日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【年通号数】公開・登録公報2020-015

【出願番号】特願2018-191375(P2018-191375)

【国際特許分類】

H 05 K 1/11 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

H 05 K 3/00 (2006.01)

H 05 K 3/40 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/11 H

H 05 K 3/46 N

H 05 K 3/46 Q

H 05 K 3/00 X

H 05 K 3/40 E

【手続補正書】

【提出日】令和3年9月6日(2021.9.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【図1】第1の実施形態に係る配線基板の構造を示す断面図である。

【図2】導電層、充填材及び第1の配線層を示す断面図である。

【図3】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その1)である。

【図4】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その2)である。

【図5】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その3)である。

【図6】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その4)である。

【図7】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その5)である。

【図8】第1の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その6)である。

【図9】第2の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その1)である。

【図10】第2の実施形態に係る配線基板の製造方法を示す断面図(その2)である。

【図11】第3の実施形態に係る半導体パッケージを示す断面図である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0065

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0066

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0066】

(第3の実施形態)

次に、第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は半導体パッケージに関する。図1_1は、第3の実施形態に係る半導体パッケージ500を示す断面図である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0067

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0067】

図1_1に示すように、第3の実施形態に係る半導体パッケージ500は、第1の実施形態に係る配線基板100、半導体チップ300、バンプ312、アンダーフィル樹脂330及び外部接続端子331を有する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】図面

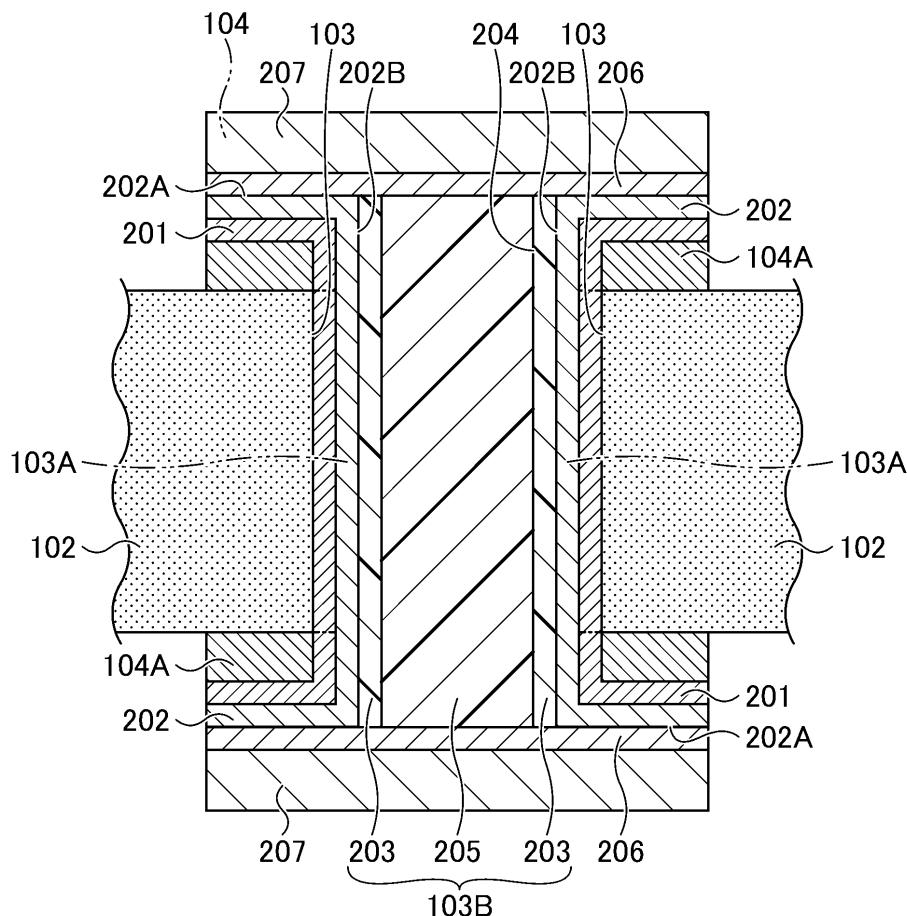
【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図2】

導電層、充填材及び第1の配線層を示す断面図



【手続補正6】

【補正対象書類名】図面

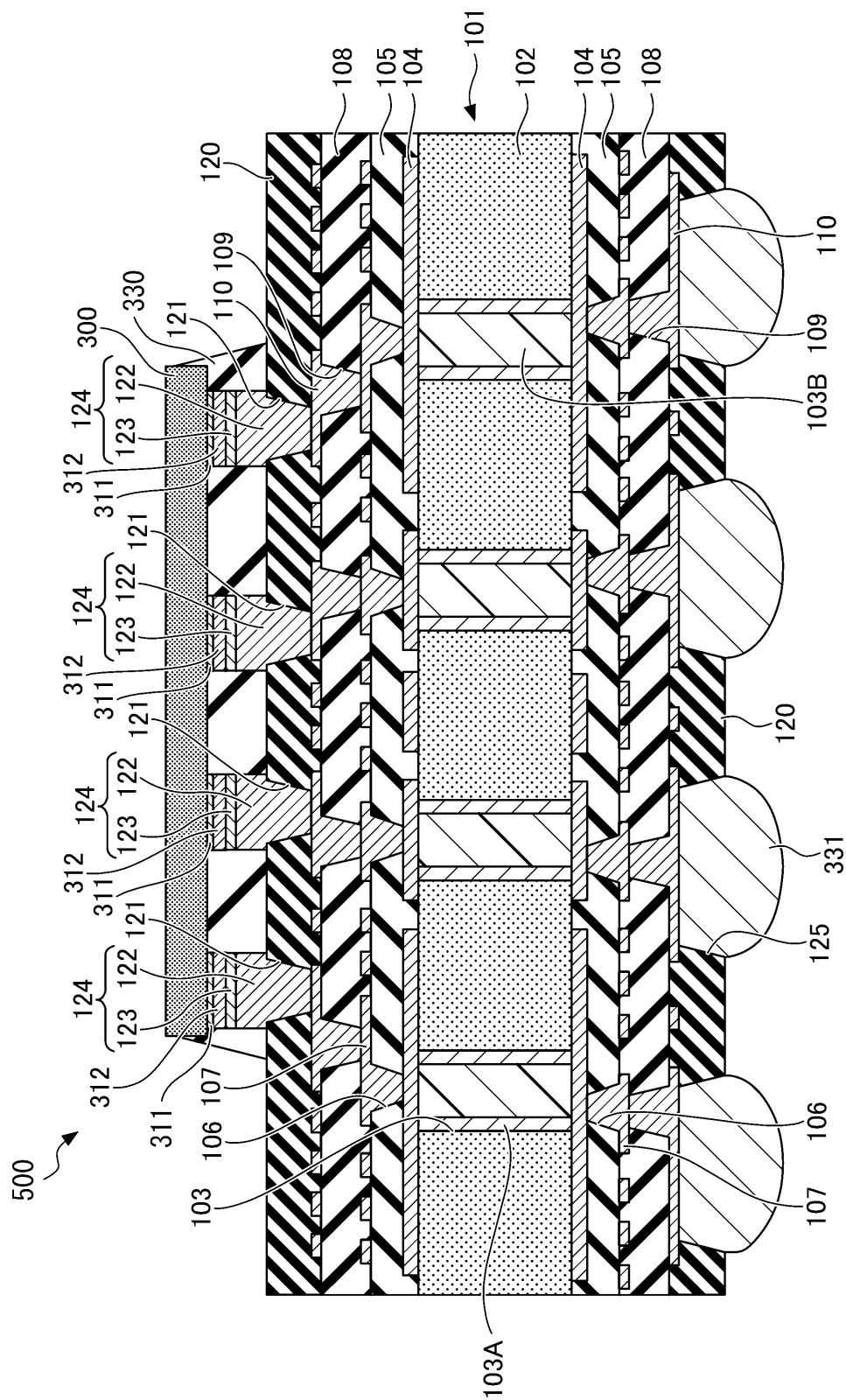
【補正対象項目名】図 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 11】

第3の実施形態に係る半導体パッケージを示す断面図



【手続補正7】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図12

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正8】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図13

【補正方法】削除

【補正の内容】